

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
【部門区分】第7部門第2区分  
【発行日】令和6年7月10日(2024.7.10)

【国際公開番号】WO2023/074342  
【出願番号】特願2023-556280(P2023-556280)  
【国際特許分類】  
H01L25/04(2023.01)  
【FI】  
H01L25/04 Z

10

【手続補正書】  
【提出日】令和6年4月23日(2024.4.23)  
【手続補正1】  
【補正対象書類名】特許請求の範囲  
【補正対象項目名】全文  
【補正方法】変更  
【補正の内容】  
【特許請求の範囲】

【請求項1】

20

第1電子素子を実装するための第1素子実装領域と、  
第2電子素子を実装するための第2素子実装領域と、を有する基体を備え、  
前記第1素子実装領域と前記第2素子実装領域は、断面視において、高さが異なる、電子素子実装用基板。

【請求項2】

前記基体は、  
上面を有する基部と、  
該基部の前記上面に位置しかつ前記第1素子実装領域を含む第1上面を有する第1台座、および/または前記基部の前記上面に位置しかつ前記第2素子実装領域を含む第2上面を有する第2台座と、を有する、請求項1に記載の電子素子実装用基板。

30

【請求項3】

前記第1台座および/または前記第2台座は、積層された複数の絶縁層により構成されている、請求項2に記載の電子素子実装用基板。

【請求項4】

前記複数の絶縁層の各々の側面は、平面視において、一致している、請求項3に記載の電子素子実装用基板。

【請求項5】

前記複数の絶縁層は、断面視において、階段状である、請求項3に記載の電子素子実装用基板。

【請求項6】

40

前記基部の平面視形状は、矩形状であり、前記第1台座および/または前記第2台座の平面視形状は、矩形状であり、

前記第1素子実装領域と前記第2素子実装領域の配置方向に平行な前記第1台座の2つの第1側面および/または前記第2台座の2つの第2側面は、平面視において、前記配置方向に平行な前記基部の2つの第3側面に一致している、請求項2に記載の電子素子実装用基板。

【請求項7】

前記基体は、その厚み方向に沿って貫通し、前記第1電子素子を収容するための段付きの第1収容穴を有し、

前記第1収容穴の第1段差面に前記第1素子実装領域が位置する、請求項1に記載の電

50

子素子実装用基板。

【請求項 8】

前記基体は、その厚み方向に沿って貫通し、前記第 2 電子素子を収容するための段付きの第 2 収容穴を有し、

前記第 2 収容穴の第 2 段差面に前記第 2 素子実装領域が位置する、請求項 1 に記載の電子素子実装用基板。

【請求項 9】

前記基体における前記第 1 素子実装領域と前記第 2 素子実装領域との間に位置し、前記基体よりも熱伝導率の小さい熱遮蔽部を備える、請求項 1 から 6 のいずれか 1 項に記載の電子素子実装用基板。

10

【請求項 10】

前記第 1 素子実装領域および / または前記第 2 素子実装領域に接続され、前記基体の厚み方向に沿って貫通したサーマルビアを備える、請求項 1 から 8 のいずれか 1 項に記載の電子素子実装用基板。

【請求項 11】

前記基体の下面に位置し、前記第 2 電子素子または前記第 1 電子素子から発生した熱を放熱するヒートシンクを備える、請求項 1 から 8 のいずれか 1 項に記載の電子素子実装用基板。

【請求項 12】

請求項 1 に記載の電子素子実装用基板と、

前記第 1 素子実装領域に実装された第 1 電子素子と、

前記第 2 素子実装領域に実装された第 2 電子素子と、を備える電子装置。

20

【請求項 13】

請求項 2 に記載の電子素子実装用基板と、

前記第 1 素子実装領域に実装された第 1 電子素子と、

前記第 2 素子実装領域に実装された第 2 電子素子と、を備える電子装置。

【請求項 14】

前記第 1 電子素子が受光素子であり、前記第 2 電子素子が発光素子である、請求項 1 2 または 1 3 に記載の電子装置。

【請求項 15】

請求項 1 2 に記載の電子装置と、

前記電子装置における基体の上面に位置する筐体と、を備える、電子モジュール。

30

【請求項 16】

請求項 1 3 に記載の電子装置と、

前記電子装置における第 1 台座および / または第 2 台座の上面に位置する筐体と、を備える、電子モジュール。

【請求項 17】

前記筐体は、

前記第 1 素子実装領域および前記第 2 素子実装領域のいずれか一方の上方を覆う第 1 筐体と、

前記第 1 素子実装領域および前記第 2 素子実装領域の両方の上方を覆う第 2 筐体と、を有する、請求項 1 6 に記載の電子モジュール。

40